

精密光学 BGA 返修设备 DEZ-R880A (NEW)

技术参数资料



DEZ-R880A 功能特点介绍

◆加热系统

- ①采用上下三温区独立控温加热系统，包括上部热风加热、下部热风混合加热方式和底部红外预热；
- ②大尺寸红外加热器：采用进口高性能碳纤维加热器、配合高温微晶面板，使 PCB 保持高效均衡预热；
- ③红外加热区可随 PCB 板 X 方向电动移动，预热均衡、范围更广，有效防止 PCB 变形；
- ④上部和下部加热器：采用高功率双通道、大口径加热器，出风口直径（非风嘴大小）高达 70mm，返修大尺寸器件时四角温度更加均匀，有效提高焊接良率；

◆光学对位系统

- ①高精度光学对位系统，采用 HDMI 1080P 显微镜级超高清 CCD，电动 X、Y 方向移动，全方位观测元器件，杜绝“观测死角”，实现元器件的精确贴装；

-
- ②贴装头角度旋转，电动 360 度自动控制；
 - ③贴装头采用伺服控制系统，确保精准贴装；
 - ④配置激光红点定位，针对不同返修产品，实现快速转换，无需设置繁琐参数；

◆操作系统

- ①人机操作界面可设置多种操作模式及自定义操作权限。
- ②自动焊接/拆卸，操作简单。
- ③人机界面采用高分辨率触摸屏。
- ④多种操作模式，一键完成芯片的拆焊、吸取，操作简单。
- ⑤配置自动喂料系统，实现自动喂料和自动收料。
- ⑥X\Y 轴采用最新设计，上部热风加热器可 Y（前后）方向电动移动，红外加热区可 X（左右）方向电动移动，在返修过程中，无需人工移动 PCB 板，只需摇杆控制就可轻松移动到所需返修位置，非常方便。

◆安全系统

- ①贴装头内置压力检测装置，保护 PCB 及元器件。
- ②贴装头上下运动系统采用高精度全伺服控制，保障贴装精度。
- ③运行过程中自动实时监测各加热器及具有超温保护功能。
- ④整机具有急停功能。

◆设备优势

- ①内置自动喂料与接料系统。
- ②贴装头角度旋转，电动 360 度旋转。
- ③选用高精度 K 型传感器，实现对 PCB、BGA 各点温度的精密检测，自动曲线分析。
- ⑤内置真空泵，无需外接气源； ϕ 角度旋转，精密微调贴装吸嘴。
- ④红外加热系统与 PCB 托板可电动大范围移动，方便维修大型 PCB、大尺寸芯片和多芯片返修。
- ⑤上下加热器采用高功率双通道加热系统，可 Y 方向电动同步移动，且下部加热器可自动上升设定高度；

◆优越的安全保护功能

本机经过 CE 认证，设有急停开关和异常事故自动断电保护装置；并加装微晶面板，防止灼伤人手和物件掉落；在焊接或拆焊完毕后具有报警功能，在温度失控情况下，电路能自动断电，拥有双重超温保护功能。

温度参数带密码保护，防止任意修改等多项安全保护及防呆功能，具有优越的安全保护功能，确保避免在任何异常状况下返修 PCB 及元器件损坏及机器自身损毁。

产品规格及技术参数

- 电 源：AC 二相 220V 或 380V 50/60Hz
- 总功率：Max 8400W
- 加热器功率：上部温区 1600W 下部温区 1600W IR 温区 5000W
- 温度控制：欧米伽 K 型热电偶闭环控制，上下独立测温，温度精度可达±1 度；
- 定位方式：V 字型卡槽、万能夹具、激光红点快速定位
- 操作控制：双摇杆操控，七轴电动运动控制，三温区自由移动
- 电器选材：精密双模控温系统、高精度伺服驱动系统、超高清光学对位系统、高清人机界面
- 喂料装置：自动喂料和自动收料装置
- 贴装精度：±0.01mm
- 芯片角度调节：360 度电动旋转
- PCB 尺寸：Max 710×490mm Min 6×6mm ；
- 适用芯片： BGA、QGN、CSP、POP、QFN、QFP、LED、Micro SMD 等
- 适用芯片：Max 120×120mm Min 0.5×0.5mm
- 外形尺寸：L1160*W1080*H1100mm
- 测温接口：5 个
- 机器重量：约 160kg
- 外观颜色：灰白